

# 名古屋大学 最先端半導体レクチャー 2025年度 秋学期

主催：名古屋大学 最先端半導体研究戦略室

共催：名古屋大学大学院 工学研究科 協賛：UPWARDS for the Future

日本国内では世界の半導体産業を支える様々な材料・製造装置・デバイス関連企業が活動しています。これら企業の技術者、研究者から、最先端半導体工学および関連産業について学べる年間全15回の講演会を開催します。「UPWARDS for the Future\*」、「中部地域半導体人材育成等連絡協議会\*\*」の各企業などから提供される講演を自由に選んで参加できます。講演終了後、講師の方々と交流できる「懇話会」も開催します。半導体業界の最新状況を知り、半導体および関連産業を多角的に捉えて、将来を考えるとともに、関係者との交流も広げられる貴重な機会です。皆様ふるってご参加下さい。

- ・日時：2025年度通年（春・秋学期）金曜日[不定期開催] 第4限（14:30 開場、14:45～16:15 講演。日付はスケジュール表を参照。講演後、懇話会を開催します）
- ・会場：EI 創発工学館・3階東・TEL オーディトリウム（予定）
- ・対象：名古屋大学の大学院生、学部学生、教職員。
- ・参加方法：参加希望者は、随時、下記 URL または右記 QR コードからつながる機構 Forms から事前登録して下さい。開催案内、最新情報などを TACT から提供します。講演会当日、会場へ直接来訪下さい。

<https://forms.office.com/r/LzzBtr03pK>

※アクセス、登録には機構アカウントへのサインインが必要です。



## ・秋学期スケジュール（※参加登録して最新情報を確認下さい）

開催日時	講演題目	講師・所属
10月10日(金) 14:45～	半導体製造を支えるプラズマエッチングの技術と人財	大矢 欣伸／東京エレクトロン宮城(株)
10月24日(金) 14:45～	SiC パワーモジュールの技術動向と研究事例	川城 史義／東芝デバイス & ストレージ(株)
11月7日(金) 14:45～	ロジック半導体のプロセスフローと半導体の信頼性について	奥田 章二／ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン(株)
11月28日(金) 14:45～	IC パッケージ基板の機能、次世代開発	渡辺 哲／イビデン(株)
12月5日(金) 14:45～	半導体洗浄技術 ～次世代半導体実現への挑戦～	田中 孝佳／(株)SCREEN セミコンダクターソリューションズ
12月19日(金) 14:45～	イメージセンサーとセンシング技術の基礎と将来展望	岡田 千丈／ソニーセミコンダクターソリューションズ(株)
1月9日(金) 14:45～	3次元構造 NAND デバイスにおけるドライエッチプロセスについて	山羽 隆／サンディスク／ウエスタンデジタル合同会社
1月23日(金) 14:45～	未定	講師検討中／Rapidus(株)

※各回、レクチャー終了後、「最先端半導体懇話会」を開催します（喫茶軽食を提供予定）。

レクチャー聴講者は無料で参加できます。多数の皆様の参加を歓迎します。

\* UPWARDS for the Future <https://www.upwardsforthefuture.com/>

\*\*中部地域半導体人材育成等連絡協議会 <https://www.chubu.meti.go.jp/c31seizo/semicon/index.html>